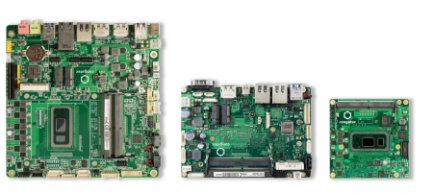
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader enquiries:** | **Press contact:** |
| **congatec Japan K.K.** | **congatec Japan K.K.** |
| Yasuyuki Tanaka | Crysta Lee |
| Phone: +81-3-64359250 | Phone: +81-3-64359250 |
| [sales-jp@congatec.com](mailto:sales-jp@congatec.com)  www.congatec.jp | crysta.lee@congatec.com  www.congatec.jp |



*Text and photograph available at:* [*https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases.html*](https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases.html)

Press release

第8世代Intel® Core™モバイルプロセッサ搭載のcongatecボードは、10年以上利用可能

**広範な可用性を備えて最大58%の性能向上**

**Tokyo, Japan, 12 June 2019 \* \* \*** 標準化およびカスタマイズされた組み込みコンピューターボードおよびモジュールの大手ベンダーであるcongatecは、第8世代Intel® Core™モバイルプロセッサ「コード名：ウイスキーレイク（Whiskey Lake）」の新しい組み込み型が、COM Express Type 6コンパクトモジュール、3.5インチSBC、Thin Mini-ITXマザーボードで現在利用可能であることを今日発表しました。コア2つが4つとなり、マイクロアーキテクチャの全体的な改良により、OEMのお客様にとって、以前の組み込み型Uシリーズプロセッサと比較して最大58%[[1]](#endnote-1) の即時性能向上となります。オプションのIntel® Optane™メモリー2やUSB 3.1 Gen2といった機能により、通常の処理はより一層反応が早くなります。プロセッサコアにより、効率的なタスクスケジューリングが可能となり、さらにRTSハイパーバイザーソフトウェアの利用をサポートすることで、入力チャネルからプロセッサコアへのI/O処理能力をさらに最適化することができます。

スペースに制限のある厳しい環境用に設計され、Intel® Core™ i7、Core™ i5、Core™ i3、Celeron® を組み込んだ新しい高性能なプロセッサボードとモジュールは、業界で初めて10年以上の長期利用を可能にします。新しい第8世代Intel® Core™モバイルプロセッサボードの発売と共に、この新しい組み込み型x86設計原則はcongatecおよび組み込み型ボードベンダー全体[[2]](#endnote-2)における第一弾となります。特に、輸送・交通部門のライフサイクルの高まるニーズに対応するこれらの新しいボードとモジュールは、お客様に追加費用を課すことなくライフサイクルを延長できるので、医療機器、工業制御、組み込みエッジクライアント、HMIなど他の組み込みアプリケーションすべてに最適です。

「当社の主な目標の1つは、OEMのお客様のために、組み込み式のコンピューター技術を可能な限り簡単に使用できるようにすることです。そのため、7年間では多くの高性能コンピューティング部門にとって不十分なことがあるため、現在は10年間以上、また開始から最長15年間長期利用可能な特定のラストタイムバイ契約に基づき、新しい第8世代Intel® Core™モバイルプロセッサに基づいた組み込み式のボードとモジュールを提供します。追加費用も掛からない当社の延長ライフサイクルにより、OEMは独自製品のライフサイクルを延長することができ、より良いROI（投資収益率）を得ることができます。」と、congatec のマーケティング担当ディレクター、クリスチャン・エダー氏（Christian Eder）は説明しています。

従来、高性能組み込みアプリケーションの多くは、それ以前に次世代プロセッサからの新たな性能向上を求めることが多かったため、7年間よりも短いライフサイクルにある傾向でした。しかし、移動車両のようないくつかの新しい組み込みアプリケーションエリアにおける認定需要の高まりと同様に、OEMは現在さらに長期間のライフサイクルに熱心に取り組んでいます。標準の組み込み式x86プラットフォームのライフサイクルを10年、さらには15年にまで延長する既製品は、組み込み式コンピューティング市場全体のお客様にとって結果的に、より大きな恩恵となります。

「10年以上長期利用可能なこの新しい組み込みバージョンのIntelアーキテクチャを手に入れることができて非常に幸せです。3D物体認識、Lidarイメージング、モバイルマッピング用に高速データストリームを得て記録する必要がある過酷な環境で、当社がターゲットとする多くのモバイル用アプリケーションにおいては、より長期間のライフサイクルは重要要件です。ワイヤレスネットワークのモニタリングや自動車試験システム、もしくはテスト車両用のデータロガーについても同様です。」と、MCTX Mobile & Embedded Computers GmbHのCEO、トーマス・アギオス氏（Thomas Hagios）は説明します。

**詳細な機能設定**

新しいconga-TC370 COM Express Type 6モジュール、conga-JC370組み込み式3.5インチSBC、conga-IC370 Thin Mini-ITXマザーボードはすべて、最新のIntel® Core™ i7、Core™ i5、Core™ i3、Celeron組み込みプロセッサを特徴としており、15年間の長期利用が可能です。メモリーは1つのプラットフォーム上で複数のOSアプリケーションを統合するという需要に合うよう設計されています。最大2400 MT/sのDDR4 SODIMMソケット2つは、合計で64GBまで利用可能です。初めて、10Gbpsの転送速度を備えたUSB 3.1 Gen2が現在はもともとサポートされており、圧縮されていないUHD動画でもUSBカメラやその他の視覚センサーから転送することができます。新しい3.5インチSBCでは、1x DisplayPort++や周辺デバイス用の電源供給にも対応するUSB-Cコネクターを介して、この性能を提供することで、動画、タッチ、電源用に1つのケーブルでモニターを接続することができます。COM Expressモジュールはキャリアボードで設定されている同様の機能に対応しています。その他のインターフェースはフォームファクタによって決まりますが、すべて最大で4096x2304ピクセル、1xギガビットイーサネット（1x TSN対応付き）を備えた合計3つの60Hz独立UHDディスプレイに対応します。新しいボードとモジュールはこれらすべてと、10W（800 MHz）から25W（ターボブーストモードで最大4.6 GHz）まで拡張可能な無駄のない15WのTDP（熱設計電力）を備えたさらに多くのインターフェースを提供します。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processor** |  | **Cores / Threads** |  | **Base freq. / Max. boost freq.[GHz]** |  | **Base TDP**  **[W]** |  | **Temperature range** |
| **Intel® Core™ i7 8665UE** |  | 4 / 8 |  | 2.0 / 3.4 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Core™ i5 8365UE** |  | 4 / 8 |  | 1.8/ 2.6 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Core™ i3 8145UE** |  | 2 / 4 |  | 1.8 / 2.2 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Celeron® 4305UE** |  | 2 / 2 |  | 1.8 |  | 15 |  | 0 to +60°C |

新しい第8世代 Intel Coreプロセッサ技術とそれに対応したcongatecのボードとモジュールに関する詳細情報は次をご覧ください: <https://www.congatec.com/intel-whiskey-lake>

**congatec AGについて**

congatec AGはドイツのデッゲンドルフに本社を置くQseven、 COM Express、 SMARC 、SBCやODMサービスなどの産業用コンピュータモジュールの専業メーカです。congatecの製品は、産業用オートメーション、医療、アミューズメント、輸送、通信、計測機器やPOSなどの様々な用途に対応できます。コアな知識や技術ノウハウは、ドライバやBSPのみならずユニークなBIOS機能も含まれています。デザイン・インの段階以降も、製品のライフサイクル・マネジメントを通してサポートを提供いたします。弊社の製品は、現代の品質基準に従ったサービプロバイダのスペシャリストによって製造されています。現在、congatecは台湾、日本、米国、オーストラリア、チェコ共和国と中国に販売拠点があります。詳しくは、 www.congatec.jp へアクセスしてください。

\* \* \*

*Intel, Intel Core and Intel Celeron are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*

1. As measured by SPECint\_rate\_base2006 N copy on Intel® Core™ i7-8665UE vs. Intel® Core™ i7-7600U

   SPEC\* CPU2000/2006 is a benchmark from the SPEC consortium that measures device performance and throughput using compute intensive application subtests.  SPECint\*\_base2000/2006 measures how fast a device completes a single integer compute task.  SPECint\*\_rate\_base2000/2006 measures throughput, or how many integer compute tasks a device can accomplish in a given amount of time.  OS support:  Desktop Windows\*, UNIX\*/Linux\* and Mac\* OS

   Full configurations for launch claims: Intel® Core™ i7-8665UE Processor, PL1= 15W TDP, 4C8T, Turbo up to 4.4GHz, Intel® UHD Graphics 620, Intel Reference Platform, Memory: 2x4GB DDR4-2400, Storage: 512GB Intel 545s SSD, OS: Microsoft Windows\* 10 Pro RS5 Build Version 1809 vs Intel® Core™ i7-7600U Processor, PL1=15W TDP, 2C4T, Turbo up to 3.9GHz, Intel® HD Graphics 620, Motherboard: Intel Reference Platform, Memory: 2x8GB DDR4-2133, Storage: 512GB Intel 545s SSD, OS: Microsoft Windows\* 10 Pro RS5 Build Version 1809 [↑](#endnote-ref-1)
2. As far as congatec research of the latest datasheets from all major competitive vendors indicates. [↑](#endnote-ref-2)